

2020-2026年中国电子材料行业市场现状分析及未来前景规划报告

报告大纲

一、报告简介

智研咨询发布的《2020-2026年中国电子材料行业市场现状分析及未来前景规划报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<https://www.chyxx.com/research/201909/782775.html>

报告价格：电子版: 9800元 纸介版：9800元 电子和纸介版: 10000元

订购电话: 010-60343812、010-60343813、400-600-8596、400-700-9383

电子邮箱: sales@chyxx.com

联系人: 刘老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

电子材料是指在电子技术和微电子技术中使用的材料，包括介电材料、半导体材料、压电与铁电材料、导电金属及其合金材料、磁性材料、光电子材料、电磁波屏蔽材料以及其他相关材料。电子材料是现代电子工业和科学技术发展的物质基础，同时又是科技领域中技术密集型学科。它涉及到电子技术、物理化学、固体物理学和工艺基础等多学科知识。根据材料的化学性质，可以分为金属电子材料、电子陶瓷、高分子电子、玻璃电介质、云母、气体绝缘介质材料、电感器、绝缘材料、磁性材料、电子五金件、电工陶瓷材料、屏蔽材料、压电晶体材料、电子精细化工材料、电子轻建纺材料、电子锡焊料材料、PCB制作材料、其它电子材料。

目前，中国大陆先进电子高端封装市场基本由国外厂商和台湾厂商主导，ASE、Amkor、SPIL等占据了绝大部分市场份额，中国大陆供货商只有江阴长电、华天科技、通富微电等少数几家，其市场占有率也少之又少。

封装测试是集成电路制造的后道工序，集成电路封装是把通过测试的晶圆进一步加工得到独立芯片的过程，目的是为芯片的触点加上可与外界电路连接的功能，如加上引脚，使之可以与外部电路如PCB板连接。同时，封装能够为芯片加上一个“保护壳”，防止芯片受到物理或化学损坏。在封装环节结束后的测试环节会针对芯片进行电气功能的确认。

电子材料的发展为我国电子信息制造业实现从无到有、从小到大的重大转变提供了重要的技术支撑，为重大工程建设、国防巩固提供了重要保障。

智研咨询发布的《2020-2026年中国电子材料行业市场现状分析及未来前景规划报告》共八章。首先介绍了中国电子材料行业市场发展环境、电子材料整体运行态势等，接着分析了中国电子材料行业市场运行的现状，然后介绍了电子材料市场竞争格局。随后，报告对电子材料做了重点企业经营状况分析，最后分析了中国电子材料行业发展趋势与投资预测。您若想对电子材料产业有个系统的了解或者想投资中国电子材料行业，本报告是您不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

第一章 电子材料行业相关概述

1.1 电子材料相关概述

1.1.1 电子材料概念

1.1.2 电子材料分类

1.1.3 电子材料特性

1.2 电子材料产业发展特点

1.2.1 寡头垄断特征

1.2.2 上下游关联性强

1.2.3 技术品种复杂

1.2.4 本土化发展趋势

1.3 电子材料细分行业介绍

1.3.1 半导体材料

1.3.2 磁性材料

1.3.3 光电子材料

1.3.4 电子陶瓷

第二章 2015-2019年中国电子材料行业发展分析

2.1 2015-2019年中国电子材料行业发展现状

2.1.1 行业发展规模

2.1.2 市场竞争格局

2.1.3 行业进出口现状

2.1.4 行业发展驱动力分析

2.1.5 电子材料重要性分析

2.1.6 细分市场投资象限分析

2.2 2015-2019年国内行业投资动态分析

2.2.1 海外并购投资动态

2.2.2 本土显示材料投资

2.2.3 南京百亿级台资项目

2.2.4 内蒙电子新材料投资

2.2.5 湖州半导体材料投资

2.2.6 宁夏硅材料投资项目

2.3 行业发展问题分析

2.3.1 对外依存度高

2.3.2 产业层次较低

2.3.3 高层次人才匮乏

2.3.4 融资压力较大

2.4 行业发展建议

2.4.1 加强政策力度

2.4.2 提高国际化水平

2.4.3 加强人才培养

2.4.4 拓宽融资渠道

2.5 中国电子材料行业前景展望

2.5.1 电子材料国产化趋势

2.5.2 电子材料低碳趋势

2.5.3 柔性电子材料发展前景

第三章 2015-2019年半导体材料行业发展分析

3.1 半导体材料行业发展综合分析

3.1.1 半导体材料发展情况

3.1.2 半导体材料实力增强

3.1.3 国内市场规模现状

3.1.4 材料国产化途径分析

3.1.5 有机半导体材料分析

3.1.6 半导体化学品综述

3.2 2015-2019年半导体硅片材料市场分析

3.2.1 国际市场垄断局面

3.2.2 大陆产能发展规模

3.2.3 国内行业发展瓶颈

3.2.4 国内项目投资动态

3.2.5 未来市场规模预测

3.3 2015-2019年半导体光刻胶市场分析

3.3.1 光刻胶相关概述

3.3.2 全球市场发展规模

3.3.3 中国市场分布格局

3.3.4 IC光刻胶市场竞争分析

3.3.5 半导体光刻胶发展趋势

3.4 2015-2019年半导体抛光材料市场分析

3.4.1 CMP抛光材料概述

3.4.2 全球市场发展规模

3.4.3 国际市场竞争格局

3.4.4 国内市场增长迅速

3.5 半导体材料行业投资潜力分析

3.5.1 国家扶持基金

3.5.2 投资空间广阔

3.5.3 并购投资机遇

3.5.4 投资风险提示

3.5.5 投资规模预测

第四章 2015-2019年光电子材料所属行业发展分析

4.1 光电子材料行业综合分析

4.1.1 光电子材料概述

4.1.2 光电子晶体材料

4.1.3 光导纤维材料

4.1.4 OLED材料概述

4.1.5 材料发展趋势分析

4.2 OLED材料

4.2.1 OLED产业链

4.2.2 全球市场格局

4.2.3 国内供给情况

4.2.4 国内竞争格局

4.2.5 竞争主体分析

4.3 玻璃基板

4.3.1 玻璃基板概述

4.3.2 产业发展规模

4.3.3 外商投资热潮

4.3.4 产业突破发展

4.3.5 超薄玻璃分析

4.4 偏光片

4.4.1 偏光片概述

4.4.2 偏光片产业链

4.4.3 全球市场现状

4.4.4 国内市场规模

4.4.5 企业投资动态

4.5 光导纤维

4.5.1 行业发展分析

4.5.2 市场运营现状

4.5.3 市场发展动态

4.5.4 发展前景向好

4.6 光纤预制棒

4.6.1 光纤预制棒概述

4.6.2 国内产业历程

4.6.3 行业发展现状

4.6.4 项目投资动态

第五章 2015-2019年磁性材料所属行业发展分析

5.1 磁性材料行业综合分析

5.1.1 磁性材料产业链

5.1.2 行业五力模型分析

5.1.3 行业主要壁垒分析

5.1.4 软磁材料市场发展

5.2 钕铁硼永磁新材料分类概述

5.2.1 粘结钕铁硼材料

5.2.2 烧结钕铁硼材料

5.2.3 热压钕铁硼材料

5.2.4 三类钕铁硼对比分析

5.3 2015-2019年钕铁硼永磁材料下游市场需求分析

5.3.1 音圈电机

5.3.2 智能手机

5.3.3 变频空调

5.3.4 节能电梯

5.3.5 传统汽车

5.4 2015-2019年国内磁性材料行业竞争主体分析

5.4.1 中科三环

5.4.2 正海磁材

5.4.3 银河磁体

5.4.4 宁波韵升

5.4.5 安泰科技

第六章 2015-2019年电子陶瓷材料所属行业发展分析

6.1 2015-2019年电子陶瓷行业综合分析

6.1.1 电子陶瓷产业链

6.1.2 波特五力模型分析

6.1.3 全球市场发展规模

6.1.4 主要原材料市场格局

6.1.5 行业发展机遇与挑战

6.2 2015-2019年氧化锆陶瓷材料行业发展情况

6.2.1 氧化锆陶瓷优势分析

6.2.2 国外龙头企业发展借鉴

6.2.3 行业下游市场应用分析

6.2.4 氧化锆陶瓷后盖市场预测

6.2.5 氧化锆贴片市场前景预测

6.3 电子陶瓷其他细分领域发展情况分析

6.3.1 高压陶瓷

6.3.2 光纤陶瓷插芯

6.3.3 燃料电池隔膜板

6.3.4 SMD封装基座

6.3.5 氧化铝陶瓷基片

6.3.6 MLCC电容器

6.3.7 微波介质陶瓷

6.4 2015-2019年电子陶瓷材料行业竞争主体分析

6.4.1 三环集团

6.4.2 顺络电子

6.4.3 国瓷材料

6.4.4 蓝思科技

第七章 2015-2019年其它电子材料发展分析

7.1 电子封装材料

7.1.1 电子封装材料概述

7.1.2 封装材料性能要求

7.1.3 传统电子封装材料

7.1.4 金属基复合封装材料

7.1.5 环氧树脂封装材料

7.1.6 电子封装材料发展趋势

7.2 覆铜板

7.2.1 PCB材料市场背景

7.2.2 全球覆铜板市场现状

7.2.3 国内行业供给需分析

7.2.4 中国外贸市场发展情况

7.2.5 “十三五”行业前景展望

7.3 超净高纯试剂

7.3.1 超净高纯试剂概述

7.3.2 全球市场分布格局

7.3.3 国内行业产能分析

7.3.4 国内市场竞争情况

7.3.5 国内行业发展预测

7.4 电子气体

7.4.1 电子气体概述

7.4.2 全球市场规模

7.4.3 国内市场格局

7.4.4 行业前景向好

第八章 中国电子材料产业投资分析 (ZY KT)

8.1 投资动态

8.1.1 本土显示材料投资

8.1.2 南京百亿级台资项目

8.1.3 内蒙电子新材料投资

8.1.4 湖州半导体材料投资

8.1.5 宁夏硅材料投资项目

8.2 投资机会

8.2.1 超薄玻璃

8.2.2 柔性材料

8.2.3 光学膜材料

8.2.4 半导体纳米晶体(量子点)

8.3 投资风险

8.3.1 新产品开发风险

8.3.2 人员流动风险

8.3.3 项目决策失误风险

8.3.4 企业资金链保障的风险 (ZY KT)

详细请访问：<https://www.chyxx.com/research/201909/782775.html>